

5月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要 4

一、宏观动态 6

 (一) 行业政策 6

 (二) 经济指数 7

二、半导体产业动态 12

 厂商动态深度解读 13

三、终端市场动态 19

 (一) 人工智能 21

 (二) 汽车 22

 (三) 医疗 23

 (四) 工业 24

 (五) 机器人 25

四、存储行情 27

 (一) 存储行情概览 27

 (二) 各存储品牌现货市场参考价 27

信息来源 33

免责声明 39

摘要

2026 年 5 月重点行情趋势	
宏观动态	● 美国：特朗普访华携半导体高管团队，H200 芯片对华出口有限放宽 ● 欧盟：批准德国 2.88 亿欧元国家援助，加码 EUV 光学镜组与碳化硅材料 ● 日本：取消 300 亿日元投资门槛，扩大传统芯片补贴范围 ● 韩国：5 月半导体出口同比暴增 169.4%，AI 需求驱动创历史新高 ● 中国台湾：第一季度 GDP 增 13.69%创 39 年新高，半导体独强多数产业衰退
产业动态	● 全球半导体市场：Q1 全球半导体销售额 2985 亿美元创历史新高，3 月同比激增 79.2% ● 美光科技：市值突破万亿美元，HBM4 加速量产 ● 德州仪器：继 4 月 1 日涨价后，7 月 1 日再启第二轮调价 ● 意法半导体：三个月内二度涨价，成本压力与 AI 需求外溢共振 ● 三星电子：5 月罢工风险或致供应中断，HBM4E 样品本月生产 ● SK 海力士：HBM 混合键合验证完成，2026 年产能已售罄 ● 南亚科技：DRAM 缺货至 2027 年底，定制化 AI 内存已创收 ● 博通：9500 系列因大批到货价格回落，9600 系列仍紧俏 ● 英伟达：5 月 GPU 需求分化，服务器 CPU 紧缺延续 ● DIODES：交期长达一年，结构性短缺短期无解 ● 中电港：Q1 财报宣告分销超级周期开启 ● 台积电：3nm 涨价反映 AI 算力需求远超预期 ● 中芯国际/华虹半导体：成熟制程迎来“AI 外溢”红利
终端市场	人工智能 ● 2026 微软印度最大数据中心预计按计划于 2026 年年中投入运营 ● 谷歌与黑石成立 AI 云基础设施合资项目 ● 阿里巴巴表示，其 AI 投资预计将超过此前 3800 亿元人民币的计划 ● 软银计划在法国投资 450 亿欧元建设 AI 数据中心 汽车 ● 比亚迪正就扩建欧洲工厂进行谈判 ● Stellantis 将投资超过 10 亿欧元，用于法国米卢斯的电动车生产 ● 丰田连续第三个月出现销量下滑 ● 2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量继续增长 医疗 ● 飞利浦报告销售额、利润率及订单增长均有所改善 ● 西门子医疗因中国诊断业务疲弱下调业绩展望 ● 怡和集团将收购 I-MED 放射影像公司 ● 罗氏将收购 PathAI，以强化 AI 诊断能力

	工业 ● 富士康提高资本支出，以扩大 AI 服务器制造能力 ● ABB 在欧洲投资 2 亿美元，扩大电网设备产能 ● 施耐德电气预计，印度数据中心业务增速将超过其核心业务增长 ● 西门子订单增长超出预期 机器人 ● Humanoid 计划在舍弗勒工厂部署多达 2000 台机器人 ● 舍弗勒瞄准大规模人形机器人订单规模 ● 日本航空开始试点使用基于宇树机器人的人形机器人方案 ● AgiBot 持续扩大人形机器人生产规模
存储行情	● DDR4：需求回暖现货涨价，美光新产线年底量产将大幅增加 DDR4 晶圆供货 ● DDR5：产能紧缺叠加大厂锁货，服务器 DDR5 涨价延续至 6 月 ● LPDDR：二季度 LPDDR4X、LPDDR5X 单价预计大幅季增 ● HBM：市场高速增长、产能紧缺，价格上行，缺口或至 2027 年 Q2 缓解 ● NAND Flash：大厂减产 MLC 闪存，导致产能锐减、价格大幅上涨 ● SSD：SSD 与内存条合约价上涨，短期现货价格下跌，呈现结构性分化 ● HDD：小容量消费级 HDD 需求疲软价格平稳，大容量企业级 HDD 行情稳健为市场主力

一、宏观动态

（一）行业政策

- **美国：特朗普访华携半导体高管团队，H200 芯片对华出口有限放宽**

5 月 13 日至 15 日，美国总统特朗普时隔九年再次访华，随行商界代表团涵盖英伟达、高通、美光科技等多家半导体龙头企业 CEO，其中英伟达 CEO 黄仁勋在启程前最后一刻受特朗普亲自邀请加入代表团，引发市场高度关注。访华期间，美方将 H200 高端 AI 芯片对华出口作为重要谈判议题。H200 的对华出口许可早在 2025 年 12 月已获美国商务部批准，但中国方面迄今未批准本土企业采购。会晤后中方采购意愿能否松动、何时实现实际交付，仍有待后续观察。美国贸易代表格里尔在访华结束后公开表示，芯片出口管制并非此次双边会谈的重点议题，刻意淡化了管制放松的信号，意在避免中方将 H200 采购视为美方整体松动的筹码。此次访华表明半导体已成为中美战略博弈的焦点，美国对华 AI 芯片管制从此前的“一刀切”封锁转向“部分高端芯片可逐案审批”的灵活模式，但出口管制整体框架并未根本松动。

- **欧盟：批准德国 2.88 亿欧元国家援助，加码 EUV 光学镜组与碳化硅材料**

5 月 20 日，欧盟委员会正式批准德国政府提供 2.88 亿欧元国家援助，用于支持半导体供应链中两座新工厂的建设。其中，2.22 亿欧元用于蔡司（Carl Zeiss）在巴登-符腾堡州建设 EUV 光学镜组生产设施，这些组件是 ASML 下一代 EUV 光刻机的核心部件；6600 万欧元用于 Zarent Materials 在萨克森-安哈尔特州建设超高纯度碳化硅源材料生产设施，采用创新的循环系统技术。这是欧盟在《芯片法案》框架下推动关键材料与设备本土化的具体落地案例。蔡司项目直接服务于全球最先进的 EUV 光刻供应链，而碳化硅材料则是第三代半导体功率器件的核心基础。此笔援助的获批表明，欧盟正从“法案宣示”走向“项目兑现”，在半导体上游关键环节加速构建自主可控能力，以降低对亚洲供应链的依赖。

- **日本：取消 300 亿日元投资门槛，扩大传统芯片补贴范围**

日本经济产业省将于 5 月修订半导体补贴条件，取消此前 300 亿日元（约 1.9 亿美元）的最低投资门槛，使中小型传统芯片制造商也能获得补助，重点扶持模拟半导体和微控制器（MCU）等产品。2021 年全球芯片短缺曾迫使丰田等车企停产，凸显过度依赖海外供应的经济安全风险。获得补贴的条件包括：国内产能提高 30% 以上，或将 30% 以上海外生产转移至日本；供应紧张时优先保证国内供货；落实防止技术外流措施。此前日本已向台积电熊本厂补贴约 1.2 万亿日元，向 Rapidus 累计补贴约 2.3 万亿日元。随着物理人工智能（AI 控制机器人与车辆）的发展，汽车、机器人等领域对传统芯片需求激增。此次下调门槛旨在鼓励中小制造商进入市场，从“偏重尖端”转向“尖端与成熟制程并重”，构建更具韧性的半导体供应体系，支撑日本政府提出的 2040 年国产半导体销

售额达 40 万亿日元的目标。

- **韩国：5 月半导体出口同比暴增 169.4%，AI 需求驱动创历史新高**

据韩国产业通商资源部 6 月 1 日发布的数据, 5 月份韩国出口总额达 877.5 亿美元, 同比增长 53.2%, 创单月历史新高, 其中半导体出口额同比增长 169.4%, 达到 371.6 亿美元, 连续三个月超过 300 亿美元, 同样创下单月最高纪录。从细分品类看, DRAM 出口增长 369.8%, NAND 闪存出口增长 206.8%。受 AI 服务器对固态硬盘需求拉动, 计算机出口飙升 290.7%至 41.8 亿美元。此外, 显示器出口增长 9.4%, 无线通信设备出口增长 12.6%。区域方面, 对中国出口增长 80.9%至 189 亿美元, 连续第七个月实现增长; 对美出口增长 59.1%至 159.7 亿美元; 对东盟出口创下 158.5 亿美元的新高。受美国大型科技公司加大对 AI 投资的影响, 存储芯片价格维持高位, 推动韩国半导体出口持续走强。1 月至 5 月累计贸易顺差已达 1019.1 亿美元, 超过去年全年水平。值得注意的是, 汽车出口受工作日减少及零部件供应中断等因素影响下降 5.9%, 显示韩国出口增长高度依赖半导体单一产业, 结构性集中风险仍需关注。

- **中国台湾：第一季度 GDP 增 13.69%创 39 年新高，半导体独强多数产业衰退**

据台湾地区“主计总处”发布的数据, 2026 年第一季度经济增长率高达 13.69%, 创下自 1987 年第三季度以来近 39 年的单季最高纪录。出口表现尤为亮眼, 按美元计价商品出口年增率飙升至 51.10%, 其中电子零组件及资通视听产品占出口比重高达 78.5%。然而, 亮眼数据背后隐藏着严重的“K 型化”结构失衡。台湾蓝涛亚洲总裁黄齐元指出, 当前经济繁荣本质上是“一个台湾, 两个世界”: AI 与半导体产业推升股市与出口, 但其从业人口仅占全台就业市场约 15%; 其余 85% 的劳动力集中在传统制造业、服务业、中小企业及农业, 多数传统产业正承受衰退压力。近九成非科技类股表现疲软, 半数以上劳工薪资低于中位数, 大量服务业从业人员月薪不足新台币 3 万元。黄齐元呼吁, 台湾若不正视产业与经济 K 型化趋势, 可能爆发严重社会问题; 对接大陆近期释出的 10 项惠台措施(精准锁定传统产业、服务业、中小企业与农业), 将成为改善台湾产业结构失衡的契机。

(二) 经济指数

- **4 月全球制造业 PMI 升至 52.6，主要经济体扩张提速但成本与供应链压力加剧**

2026 年 4 月, 全球制造业延续扩张态势, 但中东冲突带来的成本与供应链扰动显著加剧。摩根大通全球制造业 PMI 录得 52.6, 较 3 月上升 1.3 个百分点, 创四年多新高, 连续第九个月位于荣枯线上方。产出和新订单扩张加速, 但部分源于客户为防止价格上涨和供应中断而提前采购。供应商交付时间延长至 2022 年 8 月以来最差水平, 投入成本涨幅显著扩大。分国别看, 美国 PMI 升至 54.5 (创 2022 年 5 月以来新高), 产出与新订单增速均为四年来最快, 但出口连续 11 个月下滑,

就业因成本压力出现九个月来首次下降；欧元区 PMI 升至 52.2（近四年新高），八大成员国全部重返扩张区间，但投入品价格接近四年高点，产出价格涨幅为 2023 年 1 月以来最大；日本 PMI 飙升至 55.1（2022 年 1 月以来最高），产出增速为 2014 年 2 月以来最快，AI 需求与提前采购双轮驱动，但供应商交货时间延至 15 年最差；中国 PMI 升至 52.2（2020 年 12 月以来最强），产出增速近两年最快，新订单增速近五年第二快，就业稳定，企业信心增强；韩国 PMI 升至 53.6（2022 年 2 月以来最高），新订单和产出均提速，但输入价格涨幅创调查启动以来历史最高，产出价格同创新高；印度 PMI 升至 54.7，出口订单增速七个月新高，但投入成本涨幅创 44 个月最大，产出价格涨幅为六个月最高。整体来看，AI 相关需求为制造业提供关键支撑，但中东冲突引发的供应链紊乱与成本上行正成为全球制造业面临的共同挑战。

全球各地区制造业 PMI							
时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.70	51.20	48.50	50.70	57.70	52.00	49.80
2025-10	50.90	50.60	48.20	49.40	59.20	52.50	50.00
2025-11	50.50	49.90	48.70	49.40	56.60	52.20	49.60
2025-12	50.40	50.10	50.00	50.10	55.00	51.80	48.80
2026-01	50.90	50.30	51.50	51.20	55.40	52.40	49.50
2026-02	51.80	52.10	53.00	51.10	56.90	51.60	50.80
2026-03	51.30	50.80	51.60	52.60	53.90	52.30	51.60

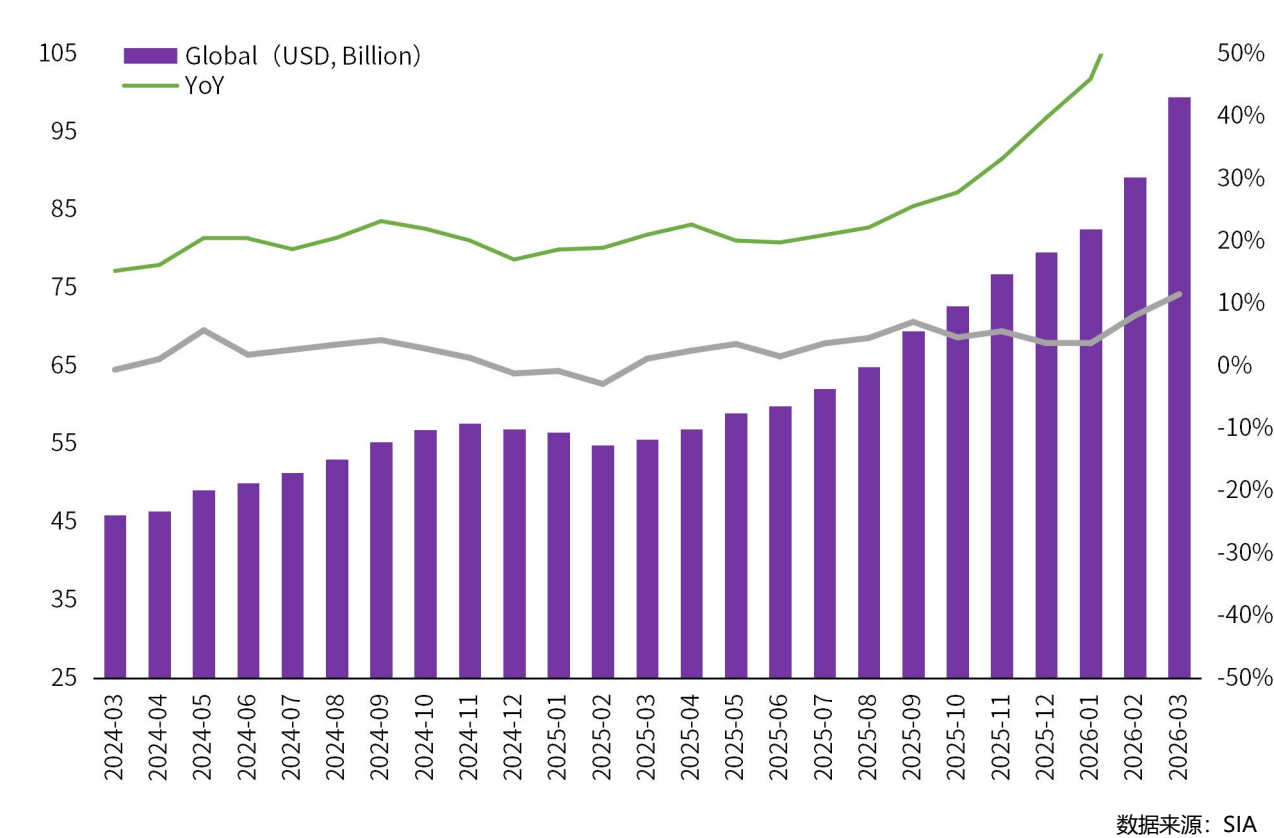
2026-04	52.60	52.20	55.10	53.60	54.70	54.50	52.20
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

数据来源：Wind

● 全球半导体销售额：3 月同比增长 79.2%，Q1 季增 25%，全年有望突破万亿美元

2026 年 5 月 4 日，半导体工业协会（SIA）公布数据显示，2026 年第一季度全球半导体销售额达 2985 亿美元，较 2025 年第四季度增长 25%。其中，3 月全球销售额为 995 亿美元，较 2 月的 895 亿美元环比增长 11.5%，较 2025 年 3 月的 555 亿美元同比大幅增长 79.2%。区域方面，3 月同比涨幅中，亚太/其他地区领涨 108.5%，美洲增长 83.1%，中国增长 74.8%，欧洲增长 46.5%，日本增长 7.4%；环比涨幅中，美洲增长 13.3%，中国增长 12.7%，亚太/其他地区增长 9.8%，欧洲增长 8.4%，日本增长 7.1%。SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，全球芯片销售额正稳步迈向 2026 年突破万亿美元的目标，第一季度销售额显著超越去年第四季度，亚太、美洲及中国市场的强劲增长凸显了半导体及下游科技产品的广泛需求。

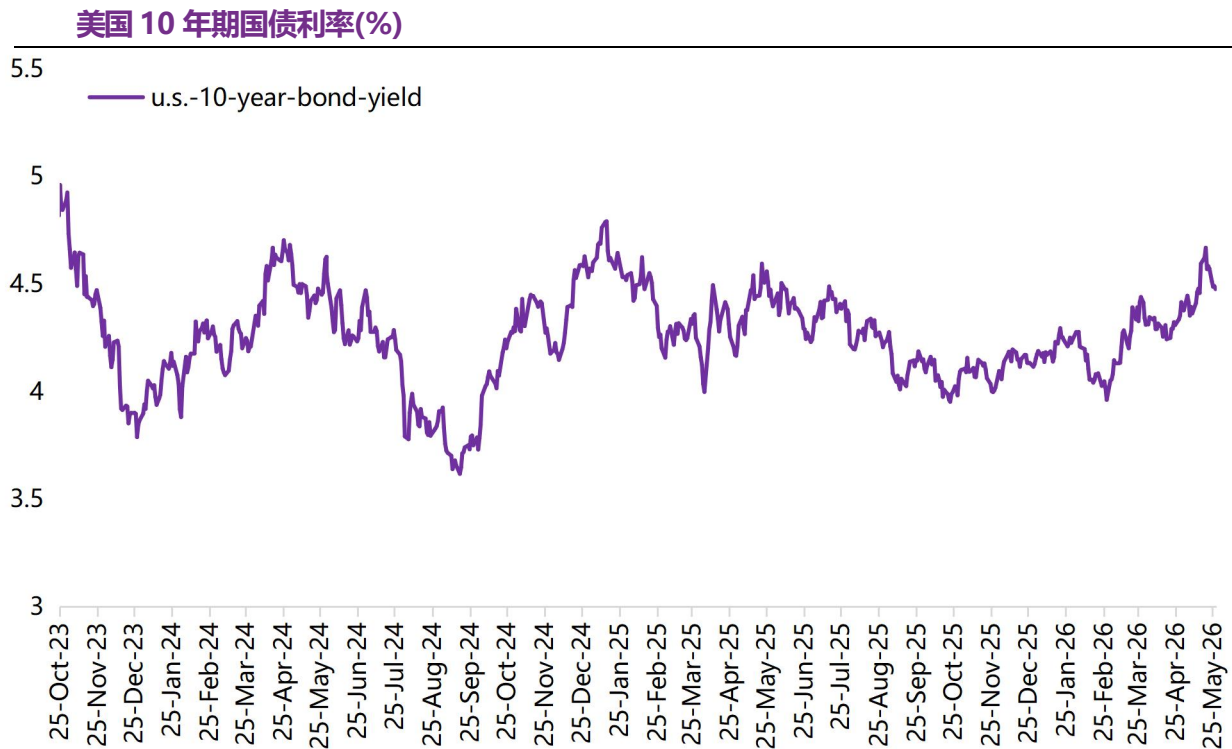
全球半导体销售额（十亿美元）



● 5 月美国 10 年期国债利率震荡上行，通胀预期与政策信号推动收益率攀升

2026 年 5 月，美国 10 年期国债收益率整体呈现震荡上行态势。月初（5 月 1 日）收于 4.378%，

月末（5月27日）收于4.477%，累计上行约9.9个基点。月内低点出现在5月1日的4.342%（盘中），高点出现在5月19日的4.687%（盘中），收盘高点为5月19日的4.669%，波动区间约4.34%-4.69%。从走势看，5月上旬收益率在4.35%-4.45%区间窄幅波动；5月12日至19日出现一轮快速上行，从4.412%升至4.669%，八个交易日累计上行约25.7个基点；随后收益率有所回落，5月20日至27日从4.57%降至4.477%，回吐部分涨幅。本轮上行的主要驱动因素包括：美国经济数据保持韧性，市场对美联储维持高利率的预期有所强化；原油价格在5月中旬再度走高，推升通胀预期；月中多位美联储官员释放偏鹰信号，市场对年内降息时点的预期进一步推迟。月末收益率小幅回落，反映市场对过度定价的修正。整体而言，5月10年期美债收益率中枢较4月有所抬升，对半导体等成长型资产的估值构成一定压力。



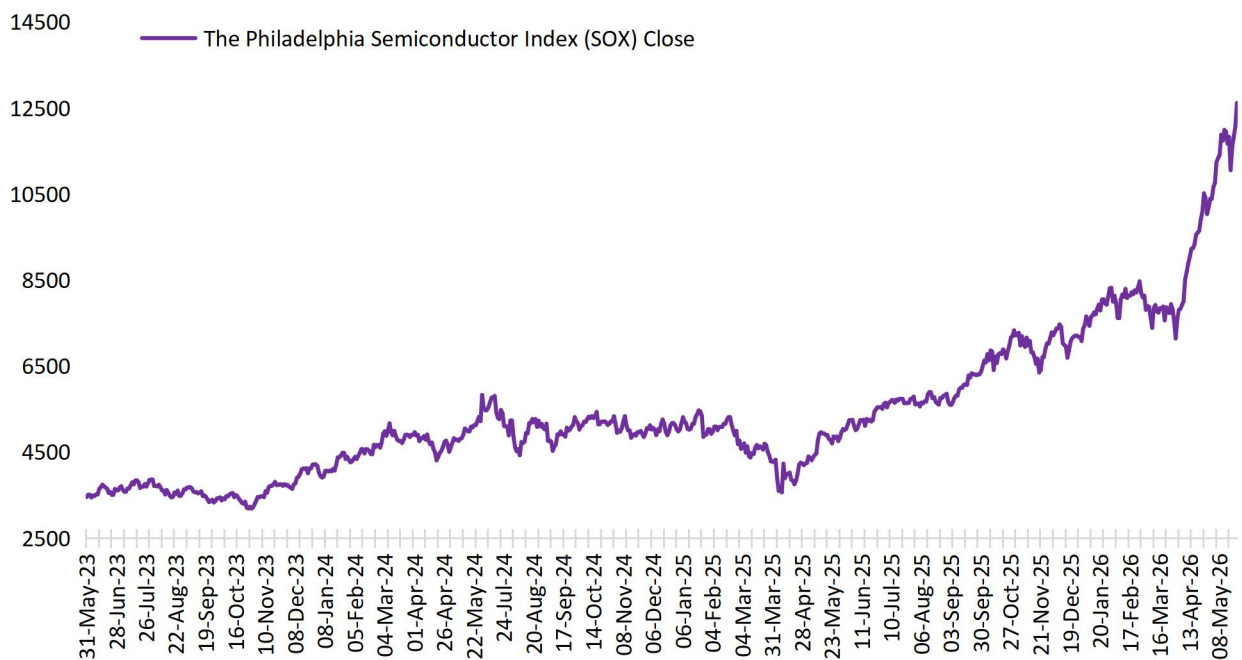
数据来源：Investing

● 5月费城半导体指数（SOX）走势分析：突破12000点延续强势，月中震荡加剧但AI主线未改

2026年5月，费城半导体指数（SOX）延续上行趋势，从4月末的10,387.84点起步，5月26日收于12,616.63点，月度累计涨幅约21.4%，继4月突破万点后进一步站稳12000点上方。月初指数加速上攻，5月11日盘中触及12,108.67点的阶段高位，随后出现技术性回调，5月12日收于11,741.47点，5月15日一度下探至11,522.27点，回吐部分涨幅；下半月指数重拾升势，5

月 22 日收于 12,070.17 点，5 月 26 日收盘创下 12,616.63 点的历史新高。全月波动率明显上升，多空博弈加剧，但整体上行趋势未改。本轮上涨的核心驱动力依然是 AI 算力需求持续超预期：英伟达 H200 芯片对华出口许可已获美方批准（有待中方采购放行）、台积电 2nm 制程进展顺利、全球 AI 服务器订单饱满等利好因素不断释放。与此同时，美国 10 年期国债收益率在 4.3%-4.5% 区间震荡，未对高估值科技板块形成明显压制。短期快速上涨后积累的回调压力在月中得到部分释放，但全球半导体行业在 AI 需求、先进制程推进及库存回补的多重支撑下，景气度仍处上行通道。市场需关注后续美联储政策信号及中美半导体博弈进展对指数走势的潜在影响。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览

厂商	动态事件	关键数据	趋势/影响（含具体型号）
美国半导体协会 SIA	5月发布 Q1 全球半导体销售额数据，创季度历史新高。	Q1 销售额 2985 亿美元（环比+25%），3 月单月 995 亿美元（同比+79.2%	MOS 存储器同比+236.4%，逻辑芯片+40.1%，模拟芯片+14.9%；2026 年全球销售额有望首破 1 万亿美元。
英飞凌 Infineon	5 月 26 日宣布 7 月 1 日起实施 2026 年第二轮涨价，覆盖部分功率半导体产品。	此前 4 月已涨一次；AI 需求推动功率器件价格持续上行。	涉及 IGBT、MOSFET、固态变压器（SST）等；AI 服务器电源架构向高压直流演进，拉动高压 MOSFET、IGBT 需求。
德州仪器 TI	继 4 月 1 日涨价后，计划 7 月 1 日实施 2026 年第二轮涨价；Q1 数据中心同比+90%。	第一轮涨幅 15%-85%；第二轮覆盖 PMIC、MOSFET 等。	覆盖数字隔离器（ISO7741）、栅极驱动器（UCC21520）、PMIC（TPS 系列）。AI 服务器需求正从 GPU 向模拟及电源管理芯片全面扩散。
意法半导体 ST	继 4 月 26 日第一轮涨价后，5 月 28 日发布第二轮涨价通知，6 月 28 日起执行。	第二轮涨价针对此前未调价产品，范围扩大。	覆盖 STM32 系列 MCU、功率 MOSFET（STP 系列）、IGBT、SiC 功率器件（SCT 系列）等。四个月内两次调价，反映车规与工业需求回暖叠加 AI 需求外溢。
联电 UMC	5 月 28 日股东会：2026 年下半年选择性涨价，2027 年将进行更广泛价格谈判。	新加坡新厂月产能 1.2 万片（可扩至 1.8 万片），2027 年量产；硅中介层月产能从 3 千片扩至 6 千片。	涨价主要针对新订单、新工艺、新产能；22/28nm 及特殊制程为重点。AI 及数据中心驱动成熟制程需求，晶圆代工涨价潮从 8 吋向 12 吋蔓延。
美光 Micron	5 月 26 日股价暴涨逾 19%，市值突破 1 万亿美元；完成铜锣厂收购。	市值达 1.01-1.023 万亿美元，瑞银目标价上调至 1625 美元。	HBM4 产能爬坡速度比 HBM3E 快两倍；铜锣厂预计贡献 2027 年超 10%全球产能；企业级 SSD 及 DDR5 内存条合约价持续上涨。
三星电子 Samsung	工会宣布 5 月 21 日至 6 月 7 日总罢工；计划 5 月生产首批 HBM4E 工程样品。	若罢工成真，预计 DRAM 全球供应中断 3%-4%，NAND 中断 2%-3%。	目标英伟达 Vera Rubin Ultra 平台；CXL 内存系统“Pangea v2”性能提升 10.2 倍；2nm 良率约 55%。
SK 海力士 SK Hynix	5 月确认 12-high HBM 混合键合验证完成；HBM 产能 2026 年已售罄。	已订购混合键合一体化系统（约 200 亿韩元）；客户转向 3-5 年长期协议。	HBM4 导入混合键合奠定基础；具备基于 HBM3E 最高 16-high 堆叠能力；DRAM 及 NAND 价格延续涨势。

南亚科技 Nanya	5月21日股东会：DRAM缺货至2027年底；定制化AI内存已产生营收。	新厂2027年下半年量产，月增3万片。	UltraWIO 超高频宽内存频宽高于JEDEC HBM标准，采用Wafer-to-Wafer Bonding，2027年上半年规模放量。
博通 Broadcom	5月1日涨价执行后，9500系列市场价回落，9600系列货源紧俏。	9560-8i <850美元，9560-16i <1700美元；9600系列全线上调。	9560-8i（华为渠道充足）、9560-16i（大批到货）、9670-24i/9660-16i（9600系列紧张）、9361-8i 1G（停产三年刚需仍旺）。
英伟达 NVIDIA	5月GPU市场：高端坚挺、中低端走弱；服务器CPU紧缺持续。	高端Pro 6000系列供应紧张；中低端库存上升。	稳定供货：RTX A400/A1000/2000 ADA/PRO 2000/4000/5000 48GB、DGX Spark 4TB；服务器CPU缺货：6544Y、6542Y等。
DIODES	5月交期普遍延长至48-52周，部分达1年；2月及4月两次涨价已全面生效。	全产品线涨幅20%-30%；由Nexperia危机+AI需求爆发双重驱动。	覆盖肖特基二极管（BAT54系列）、MOSFET（DMN系列）、逻辑IC（74HC系列）、ESD保护（PESD系列）。短缺至少持续至2027年。
中电港 CECport	5月发布2026年Q1财报：营收144.48亿元，同比大增144%；扣非净利润增速146%。	预付款同比+261%，存货环比+50%；Q1增速为分销行业最高。	分销作为半导体“晴雨表”率先复苏，预示上游原厂Q2/Q3业绩加速；“AI+存储”双轮驱动，现货订单利好明显。
台积电 TSMC	计划于2026年下半年上调3nm制程价格，最高涨幅15%，2027年或再涨5%-10%	3nm月产能从13万片增至16-17.5万片（2026年Q2）；4Q25全球晶圆代工市占率70.4%	AI芯片（NVIDIA GPU、Broadcom/Marvell ASIC）及云端自研芯片加速采用3nm，产能持续紧缺。2nm尚处良率爬坡初期，3nm为AI最稳定节点。涨价应对海外扩产及折旧压力
中芯国际/华虹半导体 SMIC/ Huahong Grace	因AI需求带动产能利用率飙升，对供应紧缺品类实施涨价；华虹2026年12英寸产品线预计进一步调涨	中芯1Q26毛利率环比提升，预计2Q26毛利率20%-22%；5月起产能利用率较去年Q3近翻倍；华虹12英寸产品涨价预期明确；MCU、独立闪存、BCD功率芯片增长强劲	AI支撑芯片需求强劲，海外AI挤占先进产能，消费电子/IoT订单回流中国成熟制程。中芯全资控股SMIC北（406亿），华虹整合华力微（82.68亿）。受惠：PMIC、MCU、BCD功率芯片

厂商动态深度解读

- 全球半导体市场：Q1 全球半导体销售额 2985 亿美元创历史新高，3 月同比激增

79.2%

美国半导体行业协会（SIA）5月发布的数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额达2985亿美元，环比增长25%，创季度历史新高。其中3月单月销售额达995亿美元，同比暴增79.2%。从品类看，MOS存储器同比增长236.4%，逻辑芯片增长40.1%，MOS微组件增长18.8%，模拟芯片增长14.9%。分地区看，亚太及其他地区营收同比增长108.5%，美洲增长83.1%，中国增长74.8%，欧洲增长46.5%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，2026年全球半导体销售额有望首次突破1万亿美元大关。

● 英飞凌：7月1日起实施年内第二轮涨价，AI驱动功率半导体结构性短缺

据TechNews及《工商时报》5月27日报道，英飞凌于5月26日通知客户及合作伙伴，自2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，这是继2026年4月第一轮涨价后的第二次上调。英飞凌表示，全球半导体供应链持续面临成本上升压力，地缘政治紧张推高了能源、原材料、运输及服务全价值链成本；与此同时，公司各产品线需求增速远超数月前的预期。为维持稳定供应，英飞凌正加速投资扩产。英飞凌特别指出，传统变压器因大量使用铜等原材料，成本和交期压力持续上升，而固态变压器（SST）等新技术因原材料消耗较少，在AI及基础设施需求竞争加剧的背景下，正成为更具吸引力的替代方案。AI算力扩张已从GPU向功率半导体全面传导，英飞凌第二轮涨价印证了这一结构性趋势。

● 德州仪器：继4月1日涨价后，7月1日再启第二轮调价

德州仪器继4月1日实施第一轮全面涨价（涨幅15%-85%）后，再次计划于7月1日启动第二轮价格调整，主要涉及PMIC、MOSFET等产品。第一轮涨价执行后，工业与汽车类核心产品现货报价上涨30%-60%，交期延长至16-26周。Q1财报显示营收48.25亿美元（+19%），数据中心收入同比大增90%，表明AI服务器需求正从GPU向模拟芯片全面传导。两次涨价间隔不足三个月，反映出成本压力持续上升与AI需求外溢的双重驱动。

● 意法半导体：三个月内二度涨价，成本压力与AI需求外溢共振

5月28日，ST向全球客户发布通知，宣布自2026年6月28日起对部分产品再次上调价格，这是继4月26日第一轮涨价后的年内第二次调价，两次间隔仅约两个月。ST在函件中表示，原材料、运输、人工等运营成本持续攀升，原有调价已无法覆盖新增成本，因此决定扩大涨价范围，重点针对此前未调价的产品，涵盖STM32系列MCU、功率MOSFET（STP系列）、IGBT及SiC功率器件（SCT系列）等核心品类。本轮涨

价的核心驱动力已从单纯成本传导演变为“成本推升+AI需求外溢”的双轮驱动模式——AI正从GPU、HBM向电源管理、功率转换环节扩散，英伟达GB300平台及高压直流（HVDC）架构的推广将进一步拉动高压MOSFET、IGBT需求；同时ST在车规SiC领域持续重资产投入，庞大资本开支下涨价成为保障利润率和现金流的重要手段。需求端方面，汽车电子、工业控制、AI电源等领域明显回暖，ST 2026年Q1营收同比增长23.0%超预期，下游补库周期已开启。对国内市场而言，STM32、STP、SCT等系列产品分销报价或出现新一轮上涨、交期拉长，但国际大厂涨价也为国产模拟及功率器件企业提供了替代窗口期。

● 联电：2026年下半年选择性涨价，2027年或全面调价；新加坡扩产加速

据《自由时报》、《MoneyDJ》、《TechNews》、《工商时报》及中央社5月28日报道，联电于当日股东会上披露了最新定价策略与扩产计划。联电财务长刘启东表示，公司计划在2026年下半年实施选择性涨价，主要针对新订单、新工艺及新开出产能，而2027年将进入更广泛的价格谈判，届时调价幅度可能更大。联电指出，近期原材料价格上涨以及新加坡扩产成本高于台湾，是推动价格调整的关键因素。现有长期合约价格将维持不变。

在产能扩张方面，联电正加速新加坡新厂建设。该厂聚焦22/28nm及部分特殊工艺，规划月产能约1.2万片，未来可扩至1.8万片，预计2026年开始逐步爬坡，但量产可能推迟至2027年。此外，联电将硅中介层（Interposer）月产能从3,000片提升至6,000片，以更好满足客户在先进封装领域的需求。公司也在评估硅光子、先进节点及先进封装等技术作为新加坡扩产路线图的一部分。

联电的涨价计划与台积电3nm再涨价的传闻形成呼应，表明晶圆代工行业正全面进入涨价周期。TrendForce此前预测2026年全球8英寸产能将减少2.4%，而12英寸成熟制程（22/28/40nm）需求受益于AI电源管理、物联网及汽车电子，供给持续偏紧。联电的选择性涨价策略既反映了成本压力，也体现了其在成熟制程细分市场的议价能力。

● 美光科技：市值突破万亿美元，HBM4加速量产

5月26日，美光科技股价单日暴涨逾19%，收报895.88美元，总市值突破1万亿美元大关，成为继台积电、英伟达之后又一家跻身“万亿美元俱乐部”的半导体企业。瑞银分析师Timothy Arcuri将目标价从535美元大幅上调至1625美元，上调幅度超过三倍。美光此前完成对力积电铜锣P5厂区18亿美元收购，TrendForce预计一期将于2027年下半年贡献产能，相当于美光2026年Q4全球产能的10%以上。在技术层面，

美光 HBM4 产能爬坡速度比 HBM3E 快两倍, 1-gamma 制程预计 2026 年年中成为产量主力, HBM4E 开发进展顺利, 预期 2027 年启动产能爬坡。存储买家正纷纷签订 3-5 年长期合同。

● **三星电子：5 月罢工风险或致供应中断，HBM4E 样品本月生产**

据韩国 Newsis、朝鲜日报报道，三星电子工会宣布将于 5 月 21 日至 6 月 7 日举行总罢工。KB 证券分析师 Kim Dong-won 预计，若罢工全面实施，DRAM 全球供应将中断 3%-4%、NAND 中断 2%-3%。三星电子目前 90% 新增晶圆产能投向 HBM 和服务器 DRAM，已正式停产 LPDDR4/4X。在先进技术方面，三星计划 5 月正式生产首批 HBM4E 工程样品，目标搭载于英伟达 Vera Rubin Ultra 加速器平台；其 CXL 内存系统“Pangea v2”性能较前代提升 10.2 倍。2nm 良率约 55%。罢工风险叠加 Q2 DRAM 合约价再涨 30% 的既定事实，将进一步加剧存储芯片供给紧张。

● **SK 海力士：HBM 混合键合验证完成，2026 年产能已售罄**

据 The Elec 4 月 29 日报道（该技术验证完成的消息在 5 月持续影响市场），SK 海力士已完成 12-high HBM 混合键合验证，正提升量产良率，并已订购应用材料与 Besi 联合开发的混合键合一体化系统（约 200 亿韩元），为 HBM4 导入混合键合奠定基础。公司同时具备基于 HBM3E 最高 16-high 的堆叠能力。在产能方面，SK 海力士 2026 年 HBM 产能已售罄，客户需求远超供给，正转向 3-5 年长期协议。Q1 财报显示营收 52.58 万亿韩元，营业利润率 72% 创纪录。SK 集团会长崔泰源表示，AI 驱动短缺或持续至 2030 年，供应缺口可能超 20%。

● **南亚科技：DRAM 缺货至 2027 年底，定制化 AI 内存已创收**

5 月 21 日，南亚科技召开 2026 年股东会。总经理李培瑛表示，DRAM 缺货状况“至少到明年底都会维持紧张”，多家客户主动要求签订超过两至三年的长约。南亚科布局的并非传统 HBM 标准品，而是定制化超高频宽内存(UltraWIO)，频宽高于 JEDEC HBM 规格，采用 Wafer-to-Wafer Bonding 技术，该产品已开始产生小幅营收，预计 2027 年上半年可望实现规模放量，且合作对象不止一家。新厂扩建预计 2027 年 Q1 装机、下半年量产，月增约 3 万片，整体产能有望在未来三年内增加 80%-100%。

● **博通：9500 系列因大批到货价格回落，9600 系列仍紧俏**

自 5 月 1 日博通原厂正式调价（整体涨幅超 10%）以来，市场呈现分化走势。受供货增量影响，9500 系列核心型号市场成交价回落：9560-8i 近期华为渠道货源充足，市

场价低于 850 美元；9560-16i 近期至 Q3 持续大批量到货，市场价不足 1700 美元。而 9600 全系列（9670-24i、9660-16i 等）原厂订货价格同步上调，该系列此前长期缺货，现阶段虽有少量货源入市但流通速度快，货源仍较紧张。值得注意的是，已停产三年多的 9361-8i 1G 凭借稳定的适配性，海内外终端市场刚需依旧旺盛。

● 英伟达：5 月 GPU 需求分化，服务器 CPU 紧缺延续

5 月 GPU 市场呈现明显分化：高端显卡（如 Pro 6000 系列）受 AI 大模型训练、影视渲染等专业场景支撑，需求稳定，价格坚挺，供应偏紧张；中低端显卡（如 Pro 4000/4500 等）受 PC 及常规设计需求偏弱影响，价格回调，渠道库存上升。以下型号目前货源充足、可稳定供货：RTX A400、RTX A1000、RTX 2000 ADA、RTX PRO 2000、RTX PRO 4000、RTX PRO 5000 48GB、DGX Spark 4TB。服务器 CPU 方面，5 代、6 代需求最旺，6544Y、6542Y、6526Y、6438N、6767P、6761P 等型号缺货严重，部分高端型号交期长达半年。价格方面，Q2 全面上调，5 月官价继续上涨。

● DIODES：交期长达一年，结构性短缺短期无解

据 SemiMedia 等专业半导体行业媒体报道，DIODES Incorporated 自 2026 年 2 月初实施了全产品线约 20% 的价格上调，并于 4 月 1 日起针对部分产品系列再度实施调价，新价格同时适用于所有新订单及现有未交订单。另据供应链信息，DIODES 部分产品交期已大幅延长至约 52 周。本轮短缺受两大结构性因素驱动。一是安世半导体（Nexperia）产能危机。荷兰政府于 2025 年 9 月依据 1952 年《物资供应法》对安世半导体实施强制管制，中国随后对安世在华工厂实施了出口禁令，导致其约 50% 的封装测试产能受限，中断对欧洲客户供应。据德国《商报》报道，安世半导体供应了欧洲汽车行业 49% 的电子元件。受影响的下游 OEM 厂商正永久性弃用该品牌，并将 DIODES 作为替代首选。二是 AI 服务器爆炸性需求。据 TrendForce 及多家行业媒体报道，随着 AI 数据中心加速建设，AI 服务器电源架构向高压直流演进，对 MOSFET、功率管理 IC 等功率半导体的需求激增，大幅挤占了 8 英寸成熟制程产能，导致全球 8 英寸晶圆代工平均产能利用率在 2026 年已攀升至近 90%，且预计供给紧张局面短期内难以缓解。在 Nexperia 订单挤占与 AI 需求爆发双重因素叠加下，Diodes 产能已不堪重负，供需失衡预计至少持续至 2027 年。受影响型号涵盖肖特基二极管（BAT54 系列）、MOSFET（DMN2990UDJ）、逻辑 IC（74HC595）、ESD 保护（PESD5V0S1BA）等。

● 中电港：Q1 财报宣告分销超级周期开启

国内分销龙头中电港 5 月发布的 2026 年 Q1 财报显示：营收 144.48 亿元，同比大增 144%；扣非净利润增速 146%，盈利质量创历史最佳。预付款同比大增 261%，存货环比增 50%，显示公司正向上游“打钱”锁产能并主动补库，对后续需求信心十足。对比国内外六家主要分销商，Q1 同比均速超 90%，进一步验证周期上升。参考历史周期走势，分销商增速领先上游原厂约 2 个季度，预示后续 TI、NXP、Infineon 等核心原厂 Q2/Q3 业绩将进一步加速。结合中电港营收结构，“AI+存储”双轮驱动趋势明确，存储、AI 服务器相关产品涨价潮将持续。

● 台积电：3nm 涨价反映 AI 算力需求远超预期

台积电 3nm 制程原以智能手机 SoC 为主要驱动力，但随着 AI 服务器进入新一轮升级周期，NVIDIA、AMD、Google、AWS 等客户加速将 AI 芯片迁移至 3nm，叠加云端厂商自研 ASIC（为降低对通用 GPU 的依赖）进一步扩大晶圆需求。Fab 18 产线利用率持续满载，即使月产能从 13 万片扩至 16–17.5 万片，仍无法满足客户排队订单。涨价背后既是供需失衡的市场结果，也是台积电应对海外扩厂（如美国亚利桑那）带来的折旧压力、维持 55% 以上毛利率的策略。2nm 尚处早期良率爬坡，量产前 3nm 将继续作为 AI 芯片最成熟、成本最优的选择，涨价趋势至少贯穿 2026 下半年至 2027 年。

● 中芯国际/华虹半导体：成熟制程迎来“AI 外溢”红利

中芯国际与华虹半导体近期产能利用率飙升，直接原因有二：一是 AI 服务器及端侧 AI 设备（ToF 传感器、电源管理芯片、机器人、电动车）带动成熟制程配套芯片需求爆发，典型产品包括 PMIC、MCU（如 STM32 系列）、BCD 功率芯片等；二是海外先进代工厂（台积电、三星）将产能优先分配给高利润的 AI 先进节点，导致消费电子、IoT 等成熟制程订单外溢至中国大陆。中芯国际已对紧缺品类涨价，2Q26 毛利率有望升至 20%–22%，5 月起产能利用率较 2025 年 Q3 近翻倍；华虹半导体 2025 年持续涨价，2026 年 12 英寸产品线预计继续提价，MCU、独立闪存、BCD 功率芯片增长强劲。这一趋势显示，中国大陆成熟制程在全球供应链中的“安全垫”作用正在增强。同时，两大代工厂正加速横向整合：中芯国际全资控股中芯北方（406 亿元收购案获批），华虹半导体整合华力微（82.68 亿元交易推进中），规模效应将进一步巩固其在成熟制程领域的成本与产能优势。

三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	动态	洞察
人工智能	微软确认，其在印度最大的资料中心将按计划于 2026 年年中投入运营，这是其持续扩大当地 AI 及云基础设施战略的一部分。	新增 AI 运算能力预计将带动企业级 SSD、DDR5 RDIMM、高速网络模块、电源管理 IC 及数据中心电力基础设施的需求增长。
	谷歌与黑石宣布成立联合 AI 云基础设施合资企业，目标约 500MW 数据中心容量，初始投资约 50 亿美元。	大规模 AI 基础设施部署预计将推动 AI 服务器、HBM、高性能企业级 SSD、液冷系统、高速互连解决方案及电源模块的采购需求。
	阿里巴巴表示，随着云和 AI 需求持续增长，其 AI 投资预计将超过此前宣布的人民币 3800 亿元承诺。	持续的 AI 基础设施扩张可能带动中国市场对 AI 服务器、DDR5 内存、企业级存储、网络设备及电源管理组件的需求增长。
	软银宣布计划在五年内投资 450 亿欧元，在法国建设以 AI 为重点的数据中心容量。	该项目预计将推动对 AI 服务器、企业级 SSD、电力分配设备、制冷基础设施及电网相关电气组件的长期需求。
汽车	比亚迪据称正在评估利用欧洲闲置工厂，以支持本地化电动车生产。	本地电动车生产可能增加对汽车 MCU、电池管理系统（BMS）芯片、电源模块、传感器及车载连接组件的需求。
	Stellantis 宣布投资超过 10 亿欧元，用于在法国米卢斯生产下一代电动车。	长期电动车生产将支撑对功率半导体、车载充电器、电池管理 IC、车载存储器及传感器的需求。
	丰田连续第三个月销量下滑，主要受中国及中东市场疲弱影响。	汽车需求走弱可能在短期内放缓疲弱地区对汽车 MCU、车载信息娱乐组件、传感器及存储器的拉动。
	2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量持续增长，成为推动电动车总量增长的主要动力。	更高的 BEV 渗透率支撑对电池管理系统（BMS）、功率模块、碳化硅（SiC）器件、温度传感器、充电组件及车规级存储器的需求。
医疗	飞利浦报告销售额、利润率及订单均实现增长。	稳定的医疗设备需求可能支撑对嵌入式处理器、医疗传感器、显示器、存储设备及电源管理组件的需求。
	西门子医疗因中国诊断业务疲弱下调业绩展望。	诊断需求走弱可能影响实验室设备电子元件、诊断模块、传感器及相关嵌入式系统的需求。
	怡和集团同意以约 24 亿美元收购 I-MED 放射影像公司。	影像网络扩张可能带动医疗工作站、存储服务器、诊断显示器及影像电子设备的需求。
	罗氏同意收购 PathAI，以强化 AI 辅助诊断与数字病理能力。	AI 病理技术的应用可能增加对图像处理硬件、医疗服务器、企业级存储及数字诊断基础设施的需求。

工业	富士康计划将资本支出提高约 30%，以扩大 AI 服务器制造产能。	AI 服务器产能扩张将带动 PCB、连接器、电源供应器、散热模组、SSD、存储器及高速互连元件的需求增长。
	ABB 将投资 2 亿美元，在欧洲扩大中压设备生产能力。	数据中心与电气化趋势可能增加对电源模块、保护继电器、传感器、开关设备及自动化组件的需求。
	施耐德电气预计印度数据中心业务增长将超过其核心业务增速。	AI 就绪型数据中心将支撑对 UPS（不间断电源）、开关设备、冷却设备、传感器、监测装置及工业功率半导体的需求。
	西门子报告订单表现强于预期，但利润面临压力。	具有韧性的工业订单可能支撑对 PLC、工业传感器、通信模块、自动化控制器及电力电子产品的需求。
机器人	Humanoid 计划到 2032 年在舍弗勒 (Schaeffler) 工厂部署多达 2000 台机器人。	工厂人形机器人部署可能增加对伺服驱动器、电机控制器、编码器、传感器、电源管理 IC 及工业级存储器的需求。
	舍弗勒预计，到 2030 年，人形机器人相关订单规模将达到数亿欧元。	机器人供应链增长可能带动执行器、电机驱动器、位置传感器、精密轴承及工业控制组件的需求。
	日本航空开始在羽田机场试用基于宇树平台的人形机器人。	机场机器人试点可能带动对视觉传感器、边缘 AI 处理器、电池管理系统（BMS）、通信模块及工业级耐用存储的需求。
	AgiBot 持续扩大人形机器人生产，强化中国在具身智能制造方面的推进。。	更大规模的机器人出货量可能带动运动控制 IC、伺服系统、摄像头、工业级 NAND、DRAM 及嵌入式计算平台的需求。

（一）人工智能

● 2026 微软印度最大数据中心预计按计划于 2026 年年中投入运营

微软在印度最大的资料中心预计于 2026 年年中上线，支持其在亚洲更广泛的 AI 与云基础设施扩张。该公司此前宣布重大印度投资计划，包括在早前 30 亿美元承诺基础上追加 175 亿美元。印度正因庞大的互联网用户群和深厚技术人才储备，成为战略性 AI 市场。这显示亚洲未来 AI 基础设施需求将进一步增强，主要受益领域包括 AI 服务器、企业级 SSD、网络设备、电源模块、液冷系统及数据中心电气基础设施。

● 谷歌与黑石成立 AI 云基础设施合资项目

谷歌与黑石宣布成立 AI 云合资企业，黑石初期投入 50 亿美元股权，用于在 2027 年前开发 500MW 数据中心容量。该项目总投资规模可能达到 250 亿美元，并将提供基于 Google TPU 的算力即服务。这表明 AI 算力需求持续增强，供应链受益领域包括 AI 服务器、内存、高速互连、电力系统、冷却及数据中心建设设备。

● 阿里巴巴表示，其 AI 投资预计将超过此前 3800 亿元人民币的计划

阿里巴巴表示，预计未来三年 AI 投资将超过此前规划的 3800 亿元人民币。公司称，AI 投入的早期回报积极，正推动其进一步扩展云计算能力。尽管季度利润不及市场预期，但投资者对管理层关于 AI 变现及未来回报的表态反应正面，显示公司持续将云与 AI 基础设施作为长期增长重点。阿里巴巴更高的 AI 支出意味着中国 AI 基础设施需求增强，这将支持 AI 服务器、企业级 SSD、网络设备、电源模块及散热组件的采购需求。在供应链本土化压力下，国内组件供应商有望受益于中国云厂商持续扩张 AI 算力能力。

● 软银计划在法国投资 450 亿欧元建设 AI 数据中心

软银计划未来五年在法国投资 450 亿欧元建设 AI 数据中心，重点布局上法兰西大区，目标约 3.1GW 容量，并可能进一步扩展。法国凭借电力充足及核能基础，正打造欧洲

AI 基础设施枢纽。施耐德电气预计将提供模块化基础设施方案，而法国电力公司将提供前发电厂场地用于数据中心改造。该项目是欧洲 AI 数据中心基础设施的重要长期需求驱动因素，可能提升对 AI 服务器、电网设备、电力分配系统、冷却系统、能源管理系统、SSD 及高速网络组件的需求，电力与热管理相关供应商或将获得更大机会。

(二) 汽车

● 比亚迪正就扩建欧洲工厂进行谈判

比亚迪据称正与 Stellantis 及其他欧洲车企洽谈接管欧洲闲置工厂，以支持其在欧洲本地化生产电动车的战略，降低关税风险并提升供应链灵活性。比亚迪更倾向于独立运营工厂，而非合资模式。本地化生产可能增加对车规级 MCU、电池管理系统（BMS）芯片、电源模块、车载充电组件、传感器及车载通信模块的需求，同时带动欧洲认证车规级元件及本地 Tier-1 供应链的采购需求。

● Stellantis 将投资超过 10 亿欧元，用于法国米卢斯的电动车生产

Stellantis 宣布投资超过 10 亿欧元，在法国米卢斯工厂生产新一代电动车，预计 2029 年开始投产。该投资是其整体电动化战略的一部分，也支持法国国家电动化规划。这进一步强化了长期电动车零部件需求，主要受益领域包括功率半导体、电池管理系统（BMS）芯片、车载充电器、汽车 MCU、车载传感器、车规级存储器及车载信息娱乐相关电子元件。

● 丰田连续第三个月出现销量下滑

丰田全球汽车销量连续第三个月下滑，主要受中国和中东市场表现疲弱影响。该结果表明，即使是全球最大车企，需求在不同地区仍呈现分化。尽管丰田在部分亚洲市场生产仍有支撑，但关键市场的销售疲软可能影响短期采购规划。这对受影响地区的汽车电子

需求构成偏弱的短期信号，客户可能在库存管理上更趋谨慎，包括汽车 MCU、车载信息娱乐模块、传感器、存储器及车载通信组件等。

● 2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量继续增长

2026 年初欧洲纯电动车（BEV）销量持续增长，成为电动车总量增长的主要驱动力。

据 Autovista24 报道，BEV 较 2025 年同期增加 146,703 辆，达到 725,375 辆，占电动车市场 67%。这表明尽管面临价格压力与竞争，欧洲仍是重要的 EV 增长区域。更高的 BEV 渗透率将支撑对电池管理系统（BMS）芯片、功率模块、SiC 器件、温度传感器、充电组件、车规级存储器、高压连接器及车辆控制电子的需求。

（三）医疗

● 飞利浦报告销售额、利润率及订单增长均有所改善

飞利浦报告销售、利润率及订单均强于预期，并维持全年业绩指引，同时持续推进生产力提升与定价策略优化。结果表明，医疗科技需求整体仍较稳定，尤其是在影像、监护及互联医疗设备领域。稳定的医疗设备需求可能支撑嵌入式处理器、医疗传感器、显示器、存储设备、通信模块及医疗级电源管理组件的采购。与此同时，这一结果对中国诊断设备需求信号偏弱，可能影响实验室仪器、诊断模块、传感器及嵌入式电子产品，但影像相关需求仍相对更具韧性。

● 西门子医疗因中国诊断业务疲弱下调业绩展望

西门子医疗因诊断业务疲弱下调 2026 年营收增长预期，尤其是中国市场表现较弱。该市场受到报销价格下降及带量采购政策影响。压力主要集中在诊断业务，而非整体医疗影像市场。这一结果对中国诊断设备需求构成偏弱信号，可能影响实验室仪器、诊断模块、传感器及嵌入式电子产品，但医疗影像相关需求仍可能保持相对韧性。

- **怡和集团将收购 I-MED 放射影像公司**

怡和集团同意以约 24 亿美元收购澳大利亚 I-MED 放射影像网络。I-MED 运营 200 多家影像诊所，每年开展数百万次检查。该交易反映出市场对放射影像网络及医疗基础设施的持续投资兴趣。影像网络扩张可能带动对诊断影像系统、医疗工作站、存储服务器、高分辨率显示器、PACS（影像存档与通信系统）基础设施及 AI 放射影像硬件的需求。

- **罗氏将收购 PathAI，以强化 AI 诊断能力**

罗氏已同意收购美国数字病理与 AI 诊断公司 PathAI，并计划将其整合至诊断业务部门，以强化 AI 赋能的病理学与伴随诊断能力。此次收购推动病理流程从人工操作向自动化、AI 辅助诊断转型。AI 病理应用的扩大可能提升对图像处理硬件、医疗服务器、企业级存储、高分辨率扫描系统及数字化诊断基础设施的需求，从而支撑医疗电子与医疗数据系统的长期需求增长。

(四) 工业

- **富士康提高资本支出，以扩大 AI 服务器制造能力**

富士康表示，AI 需求正在支撑强劲增长动能，并计划今年将资本支出提高约 30%，以扩大 AI 服务器制造产能。董事长刘扬伟指出，大型云服务商的巨额投资是主要驱动力。DigiTimes 也报道称，在算力基础设施需求推动下，富士康 AI 服务器业务正快速扩张。这对 AI 服务器供应链构成直接利好信号，可能带动服务器 PCB、连接器、电源供应器、散热模组、SSD、存储器、线缆组件、光学器件及高速互连元件的需求增长。

- **ABB 在欧洲投资 2 亿美元，扩大电网设备产能**

ABB 宣布投资约 2 亿美元，在欧洲扩大中压电网设备生产能力。该投资受数据中心、电动车、工厂、医院及大型建筑用电需求增长推动。ABB 计划扩建多个欧洲工厂，包括

在意大利新建工厂。AI 数据中心与电气化趋势正在提升电力基础设施需求，可能带动电源模块、保护继电器、工业传感器、开关设备、监控系统及自动化组件的需求增长。

- **施耐德电气预计，印度数据中心业务增速将超过其核心业务增长。**

施耐德电气预计，未来四到五年其印度数据中心业务增速将超过在印度整体业务增长，主要受 AI 就绪型基础设施、超大规模云服务商、托管数据中心运营商及企业需求推动。随着 AI 基础设施扩张，数据中心在其印度业务中的占比将持续提升。这将支撑对 UPS 系统、开关设备、冷却设备、功率半导体、传感器、监控装置及能源管理系统的需求。印度数据中心建设的持续推进也可能带来对工业电力与控制类组件的稳定需求。

- **西门子订单增长超出预期**

西门子报告订单强于预期，但利润仍承压。订单增长表明，尽管宏观环境存在不确定性，工业基础设施、自动化及电气化需求仍保持韧性。这说明工业客户仍在持续进行自动化与基础设施升级投资。稳定的工业订单有助于支撑 PLC、工业传感器、通信模块、自动化控制器、电力电子及工厂电气化组件的采购需求。但利润压力也可能使客户在价格与库存管理方面保持谨慎。

(五) 机器人

- **Humanoid 计划在舍弗勒工厂部署多达 2000 台机器人**

英国机器人公司 Humanoid 计划到 2032 年在舍弗勒制造工厂部署 1000 至 2000 台人形机器人，初期部署预计于 2026 年底至 2027 年中在德国启动。这些机器人将用于工厂任务，如搬运箱体和产线测试。这标志着人形机器人正逐步进入真实工厂应用阶段，可能带动伺服驱动器、电机控制器、编码器、传感器、工业级存储、边缘处理器、电池及电源管理方案的需求增长。

● 舍弗勒瞄准大规模人形机器人订单规模

舍弗勒表示，预计到 2030 年与人形机器人相关的订单规模将达到数亿欧元，并正将自身定位为人形机器人机械与运动部件的关键供应商。这表明传统汽车与工业供应商正加速进入机器人供应链。这将支撑执行器、精密轴承、电机驱动器、位置传感器、编码器及工业控制组件的需求增长。机器人产业有望在本世纪末前成为重要的元器件需求驱动因素。

● 日本航空开始试点使用基于宇树机器人的人形机器人方案

日本航空于 2026 年 5 月与 GMO AI & Robotics 合作，启动人形机器人试点，采用两台基于宇树平台的人形机器人。机器人用于机场的劳动密集型任务，如行李装载、集装箱运输及机舱清洁。这是人形机器人在真实物流与服务环境中的早期应用案例。商业化试点可能带动机器视觉系统、边缘 AI 处理器、电池管理系统（BMS）、电机驱动器、通信模块及工业级加固存储设备的需求增长。

● AgiBot 持续扩大人形机器人生产规模

AgiBot 作为中国增长最快的人形机器人公司之一持续受到关注。公司已报告实现规模化生产进展，并正定位为全球主要的人形机器人制造商之一。这反映出中国正推动人形机器人从原型研发阶段迈向规模化制造与商业化部署。

四、存储行情

(一) 存储行情概览

- **DDR4**: 需求回暖现货涨价，美光新产线年底量产将大幅增加 DDR4 晶圆供货。
- **DDR5**: 产能紧缺叠加大厂锁货，服务器 DDR5 涨价延续至 6 月。
- **LPDDR**: 二季度 LPDDR4X、LPDDR5X 单价预计大幅季增。
- **HBM**: 市场高速增长、产能紧缺，价格上行，缺口或至 2027 年 Q2 缓解。
- **NAND Flash**: 大厂减产 MLC 闪存，导致产能锐减、价格大幅上涨。
- **SSD**: SSD 与内存条合约价上涨，短期现货价格下跌，呈现结构性分化。
- **HDD**: 小容量消费级 HDD 需求疲软价格平稳，大容量企业级 HDD 行情稳健为市场主力。

(二) 各存储品牌现货市场参考价

三星 Samsung

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR4	16Gb(1G*16)	~\$60	DDR4	64GB(服务器)	~\$1600
	16Gb(2G*8)	~\$75		32GB(服务器)	~\$1000
	8Gb(512*16)	~\$30		16GB(服务器)	~\$650
	8Gb(1G*8)	~\$55		32GB(PC)	~\$410
	4Gb(256*16)	~\$12		16GB(PC)	~\$170
	4Gb(512*8)	~\$14		8GB(PC)	~\$90
				4GB(PC)	~\$55

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR5	96GB(服务器)	~\$3800	SSD	7680GB/7.68TB (企业级)	~\$3250
	64GB(服务器)	~\$2500		3840GB/3.84TB (企业级)	~\$1700
	32GB(服务器)	~\$1200		1920GB/1.92TB (企业级)	~\$1300
	16GB(服务器)	~\$650		960GB/1TB (企业级)	~\$750
	32GB (PC)	~\$450		480GB (企业级)	~\$460
	16GB (PC)	~\$250		240GB (企业级)	~\$250
	8GB (PC)	~\$150		2TB (消费级)	~\$350
				1TB (消费级)	~\$250
				512GB (消费级)	~\$185

品类	规格	价格 (美金)
NAND flash	1Gb-SLC	~\$3.4-3.8
	2Gb-SLC	~\$4-4.4
	4Gb-SLC	~\$6.5-7.3
	8Gb-SLC	~\$14.2-15
	16Gb-SLC	~\$27-35

SK 海力士 SK Hynix

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR4	16Gb(1G*16)	~\$60	DDR4	64GB(服务器)	~\$1800
	16Gb(2G*8)	~\$65		32GB(服务器)	~\$1100
	8Gb(512*16)	~\$46		16GB(服务器)	~\$750
	8Gb(1G*8)	~\$40		32GB (PC)	~\$420
	4Gb(256*16)	~\$9		16GB (PC)	~\$200
				8GB (PC)	~\$150
				4GB (PC)	~\$85

品类	规格	价格 (美金)
DDR5	96GB(服务器)	~\$3900
	64GB(服务器)	~\$2500
	32GB(服务器)	~\$1200
	16GB(服务器)	~\$650
	32GB (PC)	~\$430
	16GB (PC)	~\$240
	8GB (PC)	~\$150

品类	规格	价格 (美金)
NAND flash	1Gb-SLC	~\$3.3-3.7
	2Gb-SLC	~\$3.6-4.3
	4Gb-SLC	~\$6.5-6.9

美光 Micron

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR4	16Gb(1G*16)	~\$65	DDR4	64GB(服务器)	~\$1700
	16Gb(2G*8)	~\$75		32GB(服务器)	~\$900
	8Gb(512*16)	~\$40		16GB(服务器)	~\$750
	8Gb(1G*8)	~\$55		32GB(PC)	~\$420
				16GB(PC)	~\$290
				8GB(PC)	~\$170
				4GB(PC)	~\$80

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR5	96GB(服务器)	~\$4100	SSD	7680GB/7.68TB (企业级)	~\$4500
	64GB(服务器)	~\$2300		3840GB/3.84TB (企业级)	~\$2500
	32GB(服务器)	~\$1200		1920GB/1.92TB (企业级)	~\$1500
	16GB(服务器)	~\$700		960GB/1TB (企业级)	~\$950
	32GB (PC)	~\$460		480GB (企业级)	~\$500
	16GB (PC)	~\$280		240GB (企业级)	~\$330
	8GB (PC)	~\$160			

品类	规格	价格 (美金)
NAND flash	1Gb-SLC	~\$3.3-3.7
	2Gb-SLC	~\$3.5-4.1
	4Gb-SLC	~\$6.2-6.8
	8Gb-SLC	~\$14-14.6

铠侠 KIOXIA

品类	规格	价格 (美金)
NAND flash	1Gb-SLC	~\$3.4-3.7
	2Gb-SLC	~\$3.3-3.7
	4Gb-SLC	~\$6.6-7.2
	8Gb-SLC	~\$12.4-13.8
	16Gb-SLC	~\$28-45

旺宏 MXIC

品类	规格	价格 (美金)
NAND flash	1Gb-SLC	~\$4
	2Gb-SLC	~\$6.5
	4Gb-SLC	~\$9

华邦 Winbond

品类	规格	价格 (美金)
NAND flash	1Gb-SLC	~\$3.2-5.2
	2Gb-SLC	~\$5.2
	4Gb-SLC	~\$8.8

南亚 Nanya

品类	规格	价格 (美金)
DDR4	8Gb(512*16)	~\$45
	8Gb(1G*8)	~\$47
	4Gb(256*16)	~\$22
	4Gb(512*8)	~\$25

英睿达 Crucial

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR4	32GB (PC)	~\$360	DDR5	32GB (PC)	~\$400
	16GB (PC)	~\$170		16GB (PC)	~\$230
	8GB (PC)	~\$110		8GB (PC)	~\$130

金士顿 Kingston

品类	规格	价格 (美金)	品类	规格	价格 (美金)
DDR4	64GB(服务器)	~\$1580	DDR5	96GB (服务器)	~\$3960
	32GB(服务器)	~\$1050		64GB (服务器)	~\$2480
	16GB(服务器)	~\$640		32GB (服务器)	~\$1080
	32GB (PC)	~\$365		16GB (服务器)	~\$580
	16GB (PC)	~\$185		32GB (PC)	~\$400
	8GB (PC)	~\$118		16GB (PC)	~\$230
				8GB (PC)	~\$115

西数 WD

品类	规格	价格 (美金)
HDD	24TB	~\$1130
	20TB	~\$940
	18TB	~\$900
	16TB	~\$800
	8TB	~\$490

希捷 Seagate

品类	规格	价格 (美金)
HDD	24TB	~\$1150
	20TB	~\$950
	18TB	~\$920
	16TB	~\$820
	8TB	~\$500

东芝 Toshiba

品类	规格	价格 (美金)
HDD	24TB	~\$1120
	20TB	~\$930
	18TB	~\$880
	16TB	~\$790
	8TB	~\$480

以上价格数据截至 2026 年 5 月，受市场供需影响，价格浮动明显，价格仅作参考

信息来源

- [1] Bloomberg. "TSMC Starts Work on Third Arizona Chip Plant to Boost US Output." Bloomberg, May 2026.
- [2] Bureau of Labor Statistics. "Consumer Price Index – March 2026." April 10, 2026.
- [3] CBS News. "Trump, Xi meet in Beijing as trade, Taiwan, AI chip talks heat up." CBS News, May 14, 2026.
- [4] Central News Agency. "UMC Shareholder Meeting Discloses Pricing and Expansion Plans," May 28, 2026.
- [5] CNN Business. "Trump meets Xi in Beijing as trade tensions simmer." CNN Business, May 13, 2026.
- [6] CNBC. "10-year Treasury yield jumps as Fed officials signal patience on rates." CNBC, May 15, 2026.
- [7] CNBC. "US, China discuss AI chips, trade and Taiwan during Trump-Xi summit." CNBC, May 13, 2026.
- [8] Commercial Times. "TSMC 3nm Expected to Rise Another 15% in 2H26," May 28, 2026.
- [9] EET China. "本月起，这些元器件商开始涨价." EET China, 2026 年 4 月 2 日.
- [10] The Elec. "SK Hynix Completes 12-high HBM Hybrid Bonding Verification." The Elec, April 29, 2026.
- [11] Federal Reserve. "Federal Reserve issues FOMC statement." Federal Reserve Board, April 29, 2026.
- [12] Grippe, Jamie. "Trump administration approves export licenses for Nvidia H200 chips to China." Washington Post, May 16, 2026.
- [13] Handelsblatt. "German Carmakers Face Chip Shortages Due to Nexperia Crisis." Handelsblatt, May 2026.
- [14] Investing.com. "United States 10-Year Bond Yield Historical Data." Investing.com, May 2026.
- [15] J.P. Morgan. "Global Manufacturing PMI." J.P. Morgan and S&P Global, April 2026.
- [16] KB Securities. "Analysis on Samsung Electronics Strike Impact." KB

Securities, May 2026.

[17] Korea Newis. "Samsung Electronics Union Announces General Strike." Korea Newis, May 2026.

[18] Liberty Times. "UMC Plans Selective Price Hikes in 2H26, Broader Negotiations in 2027," May 28, 2026.

[19] MoneyDJ. "UMC Accelerates Singapore Expansion; Interposer Capacity to Double," May 28, 2026.

[20] TechNews. "Infineon Announces Second 2026 Price Hike Effective July 1," May 27, 2026.

[21] TechNews. "UMC to Implement Wafer Price Adjustments in 2H26," May 28, 2026.

[22] The Korea Times. "Lee Jae-myung calls Samsung union demands 'excessive' ." The Korea Times, May 15, 2026.

[23] The New York Times. "Trump Arrives in China With Chips, Tariffs and Taiwan on Agenda." The New York Times, May 13, 2026.

[24] Reuters. "After Samsung strike averted, bonus disparity sparks new discord." Reuters, May 23, 2026.

[25] Reuters. "Factbox: AI chip controls, Taiwan investment rule in focus as Trump meets Xi." Reuters, May 12, 2026.

[26] Reuters. "Nvidia CEO Huang joins Trump on China trip, H200 chip on agenda." Reuters, May 13, 2026.

[27] Reuters. "Samsung Electronics reaches wage deal with union, averting strike." Reuters, May 21, 2026.

[28] S&P Global. "Eurozone Manufacturing PMI – April 2026." S&P Global, April 30, 2026.

[29] S&P Global. "Global Manufacturing PMI – April 2026." S&P Global and J.P. Morgan, May 5, 2026.

[30] S&P Global. "Japan Manufacturing PMI – April 2026." S&P Global, April 30, 2026.

[31] S&P Global. "US Manufacturing PMI – April 2026." S&P Global, May 1, 2026.

[32] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Semiconductor

Sales Increase 25% from Q4 2025 to Q1 2026.” SIA, May 4, 2026.

[33] SemiMedia. “Diodes to Raise Prices on Select Products from April 1.” SemiMedia, March 30, 2026.

[34] SIA (Semiconductor Industry Association). “Global Semiconductor Sales Reach \$298.5 Billion in Q1 2026.” SIA, May 2026.

[35] Sinofaith. “SMIC’s 1Q26 Results and 2Q26 Guidance Exceed Expectations, Highlighting AI-Driven Demand.” Sinofaith, May 19, 2026

[36] TrendForce. “Capacity Cuts and Surging Demand for AI Power ICs Set Stage for Mature-Node Foundry Price Increases.” TrendForce, May 7, 2026.

[37] TrendForce. “Impact of Micron’s Tongluo Fab Acquisition on Global DRAM Capacity.” TrendForce, May 2026.

[38] UBS. “Micron Technology Price Target Raised to \$1,625.” UBS, May 26, 2026.

[39] The Wall Street Journal. “Trump, Xi Meet in Beijing Amid Technology Tensions.” The Wall Street Journal, May 13, 2026.

[40] World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). “March 2026 Semiconductor Sales Data.” WSTS, May 2026.

[41] Yonhap News Agency. “Samsung Electronics’ Q1 operating profit jumps 756% on AI chip demand.” Yonhap News Agency, April 30, 2026.

[42] AASTOCKS. “据报台积电(TSM.US)3 纳米制程下半年加价高达 15% 明年或再加一成.” AASTOCKS, 2026 年 5 月 27 日.

[43] 财联社. “功率半导体密集涨价！AI 数据中心成最大推手 业内预计供需紧张短期难解.” 财联社, 2026 年 5 月 13 日.

[44] 财联社. “意法半导体年内第二次宣布涨价.” 2026 年 5 月 31 日.

[45] 蔡司半导体. “EUV 微影和技术——蔡司半导体.” zeiss.com.tw.

[46] 朝鲜日报. “三星电子工会宣布总罢工.” 朝鲜日报, 2026 年 5 月.

[47] 大成律师事务所. “荷兰安世半导体案的法律审视.” 大成律师事务所, 2026 年 1 月 26 日.

[48] 东方财富网. “406 亿元并购 ‘尘埃落定’ 中芯国际有望增厚利润.” 东方财富网, 2026 年 5 月 17 日.

[49] 富途牛牛. “报道：台积电 3 纳米下半年涨价 15%，明年或再涨 10%.” 富途牛牛, 2026 年 5 月 27 日.

- [50] 格隆汇. “时隔两个月 意法半导体再度涨价.” 2026 年 5 月 31 日.
- [51] 工商时报. “39 年最高! 台湾首季 GDP 成长 13.69%.” 《工商时报》, 2026 年 5 月 1 日.
- [52] 公视新闻网. “蓝拟推芯片国安法限制输出 钟佳滨: 政府已有管制.” 公视新闻网, 2026 年 5 月 10 日.
- [53] 国际电子商情. “日本拟扩大成熟制程芯片补贴, 取消 1.9 亿美元投资门槛.” 国际电子商情, 2026 年 5 月 14 日.
- [54] 华虹半导体. “2026 年第一季度业绩公告.” 华虹半导体, 2026 年 5 月.
- [55] 经济日报 (台湾). “台湾通过产创条例修正案, 确立 N-1 技术限制原则.” 《经济日报》, 2026 年 4 月 30 日.
- [56] 界面新闻. “MCU 巨头意法半导体年内二次涨价.” 2026 年 5 月 31 日.
- [57] 科技新报. “三星罢工危机暂解, 加薪 6.2%、芯片部门按业绩 10.5%计提奖金.” 科技新报, 2026 年 5 月 21 日.
- [58] 联合新闻网. “主计总处上修 Q1 经济成长至 13.69% 创近 39 年单季最高.” 《联合新闻网》, 2026 年 5 月 1 日.
- [59] 贸易杂志 (台湾). “日本政府计划放宽成熟制程半导体的补助门槛.” 贸易杂志, 2026 年 5 月 18 日.
- [60] 美国半导体行业协会(SIA). “2026 年第一季度全球半导体销售额达 2985 亿美元.” SIA, 2026 年 5 月 4 日.
- [61] 每日经济新闻. “美国 10 年期国债收益率涨 3.5 个基点, 报 4.447%.” 每日经济新闻, 2026 年 5 月 12 日.
- [62] 南亚科技. “2026 年股东会简报.” 南亚科技, 2026 年 5 月 21 日.
- [63] 搜狐. “三星电子工会: 成员已批准初步薪资协议, 投票支持率为 73.7%.” 搜狐, 2026 年 5 月 27 日.
- [64] 钛媒体. “功率半导体, 缺货.” 钛媒体, 2026 年 5 月 5 日.
- [65] 新浪财经. “交银国际: 中芯国际 2Q26 指引超预期 AI 对需求总体驱动效应凸显.” 新浪财经, 2026 年 5 月 19 日.
- [66] 新浪财经. “全球半导体销售额: 3 月同比增长 79.2%, Q1 季增 25%.” 新浪财经, 2026 年 5 月 6 日.
- [67] 新浪财经. “暂缓罢工! 三星电子全员加薪 6.2% 芯片部门按业绩 10.5%计提奖金.” 新浪财经, 2026 年 5 月 21 日.
- [68] 证券之星. “美国 4 月标普全球制造业 PMI 终值 54.5.” 证券之星, 2026 年 5

月 1 日.

[69] 中芯国际. “2026 年第一季度业绩公告.” 中芯国际, 2026 年 5 月 19 日.

[70] 中电港. “2026 年第一季度报告.” 中电港, 2026 年 5 月.

[71] 中信建投证券. “电子行业周报: 模拟 IC 大厂集中开启新一轮涨价.” 2026 年 6 月 1 日.

[72] 中时新闻网. “为何川普不带黄仁勋访陆? 外媒解析原因不单纯.” 中时新闻网, 2026 年 5 月 12 日.

[73] 证券之星. “中芯国际(688981): 淡季业绩稳健 AI 需求暴增未来指引超预期.” 证券之星, 2026 年 5 月 19 日.

[74] Reuters. “Microsoft’ s Biggest India Data Center on Track for Mid-2026, Executive Says.” May 19, 2026.

[75] Reuters. “Google, Blackstone Create New AI Cloud Company, WSJ Reports.” May 19, 2026.

[76] Reuters. “Alibaba Quarterly Revenue Rises 3%, Missing Estimates.” May 13, 2026.

[77] Reuters. “SoftBank to Build Up AI Data Centres in France With Major Investment.” May 30, 2026.

[78] Reuters. “BYD Talks With Stellantis, Others About Taking Over Europe Plants.” May 13, 2026.

[79] Reuters. “Stellantis Will Invest \$1 Billion to Produce New-Generation EVs in Mulhouse Factory.” May 26, 2026.

[80] Reuters. “Toyota Sales Drop for Third Month of Declines in China and Middle East.” May 28, 2026.

[81] Autovista24. “Revealing Transformation in the 2026 European EV Market.” 2026.

[82] Philips. “First Quarter Results 2026.” 2026.

[83] Reuters. “Siemens Healthineers Cuts 2026 Outlook on Diagnostics Weakness.” May 7, 2026.

[84] Ground News. “Jardine Matheson to Acquire Australia’ s I-MED Radiology in \$2.4 Billion Deal.” 2026.

[85] ITN Online. “Roche to Acquire PathAI to Drive Digital Pathology Diagnostics.” 2026.

[86] Reuters. "Foxconn Has Immense Confidence in Growth Momentum Due to AI, Chairman Says." May 29, 2026.

[87] DigiTimes. "Foxconn AI Server and CPO Business 2026." 2026.

[88] Reuters. "EDF to Invest \$240 Million in French Electrification Plan." May 26, 2026.

[89] Reuters. "Schneider Electric Sees India Data Center Business Outpacing Core Growth." May 25, 2026.

[90] DC Velocity. "Schaeffler to Use Thousands of Humanoid Robots in Auto Parts Factories." 2026.

[91] KraneShares. "Humanoid Robotics in 2026: The Race From Pilot to Platform." 2026.

[92] Memeburn. "Physical AI Is Sending Humanoid Robots to Real Factory Floors in 2026." 2026.

[93] Siemens Orders (Google Search Result). "Siemens Orders Rise More Than Expected." 2026.

[94] 半导铁盒 IC-BOX, 每周存储市场行情监测, 2026.5.30

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

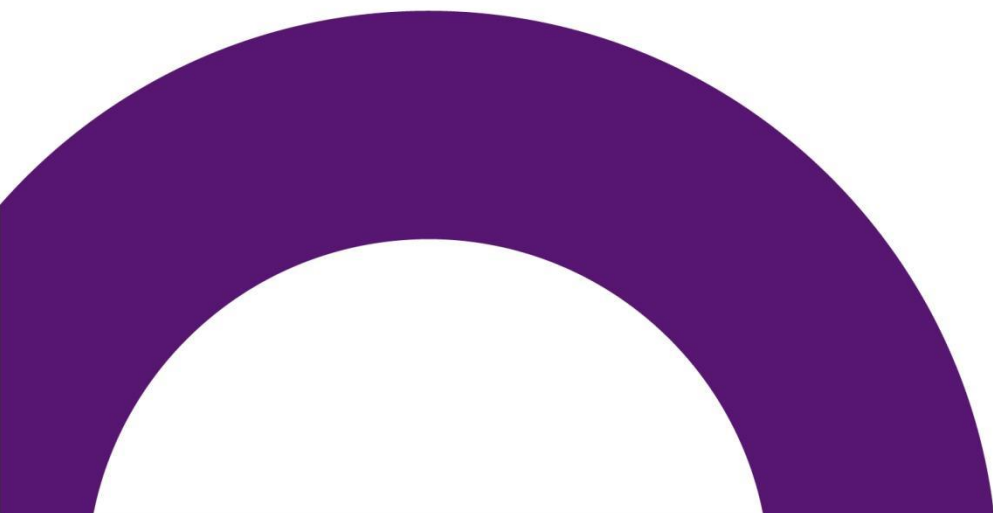
安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 5 月

360iC 安芯易



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

